

The Top Assisting Partner in the **AI Supply Chain**

C SUN Q2 Investor's meeting

A **G2C+** Alliance Company
T STRATEGY ALLIANCE

Forward-looking Statement



- Information included in this presentation that are not historical in nature are "forward-looking statements". C Sun cautions readers that forward looking statements are based on C Sun's reasonable knowledge and current expectations and are subject to various risks and uncertainties.
- Actual results may differ materially from those contained in such forward-looking statements for a variety of reasons including without limitation, risks associated with demand and supply change, manufacturing and supply capacity, design in, time to market, market competition, industrial cyclicity, customer's financial condition, exchange rate fluctuation, legal actions, amendments of the laws and regulations, global economy change, natural disasters, and other unexpected events which may disrupt C Sun's business and operations.
- Accordingly, readers should not place reliance on any forward-looking statements. Except as required by law. C Sun undertakes no obligation to update any forward-looking statement, whether as a result of new information, future events, or otherwise.

Computex 2026 | NVIDIA GTC Keynote Backdrop



G2C+ Alliance



2026
Partner



NVIDIA & 台積電





NVIDIA

2026
Partner

G2C+ Alliance: The Platform Advantage

Control (東捷)

Laser Application (雷射應用)
Sputtering & Dry Etching
(真空濺鍍 & 乾蝕刻)

GMM (均華)

- Die Attach (黏晶)
- Chip Sorter (揀晶)

2,400+

聯盟總人數
(Total Alliance Workforce)

900+

研發人員
(R&D Personnel)

© Sun (志聖)

- Thermal (熱)
- Bonder (壓合)
- Lamination (貼膜)
- Wet Process (濕製程)
- Peeling (撕膜)
- UV/Plasma (光/電漿)

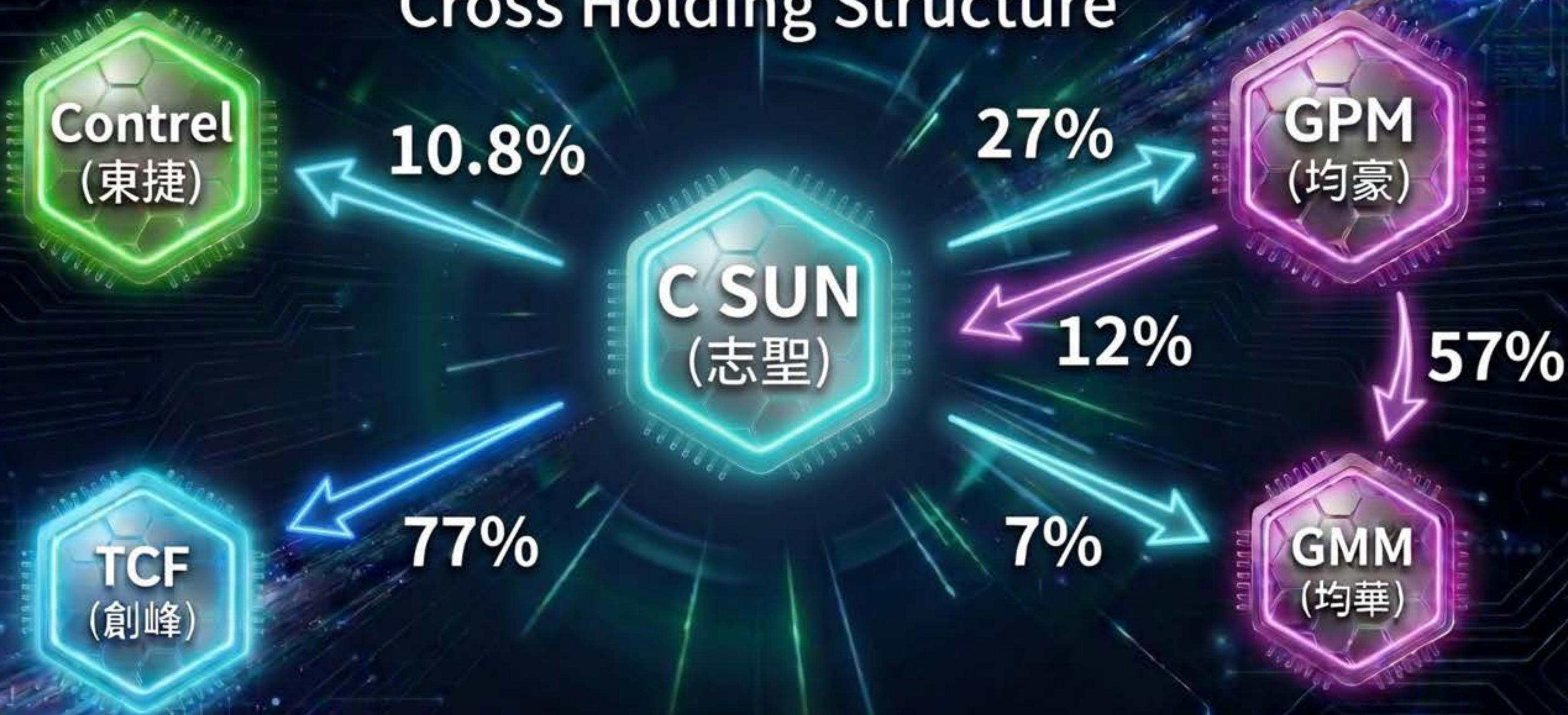
GPM (均豪)

- AOI (檢測)
- Metrology (量測)
- Grinding (研磨)
- Polishing (拋光)



G2C+ Strategy Alliance

Cross Holding Structure



台灣半導體戰略走廊

— 串聯台灣半導體製造生態系 —

客戶先進封裝據點

- 龍潭
- 新竹竹科
- 台中中科
- 嘉義
- 台南南科
- 高雄橋頭
- 高雄

G2C+ 聯盟成員

- CSUN
- GPM
- GMM
- Contrel



共同開發網絡

- ✓ 在地服務
- ✓ 零時差支援
- ✓ 共同開發



生產韌性

- ✓ 彈性產能
- ✓ 快速回應
- ✓ 供應鏈韌性



Speed

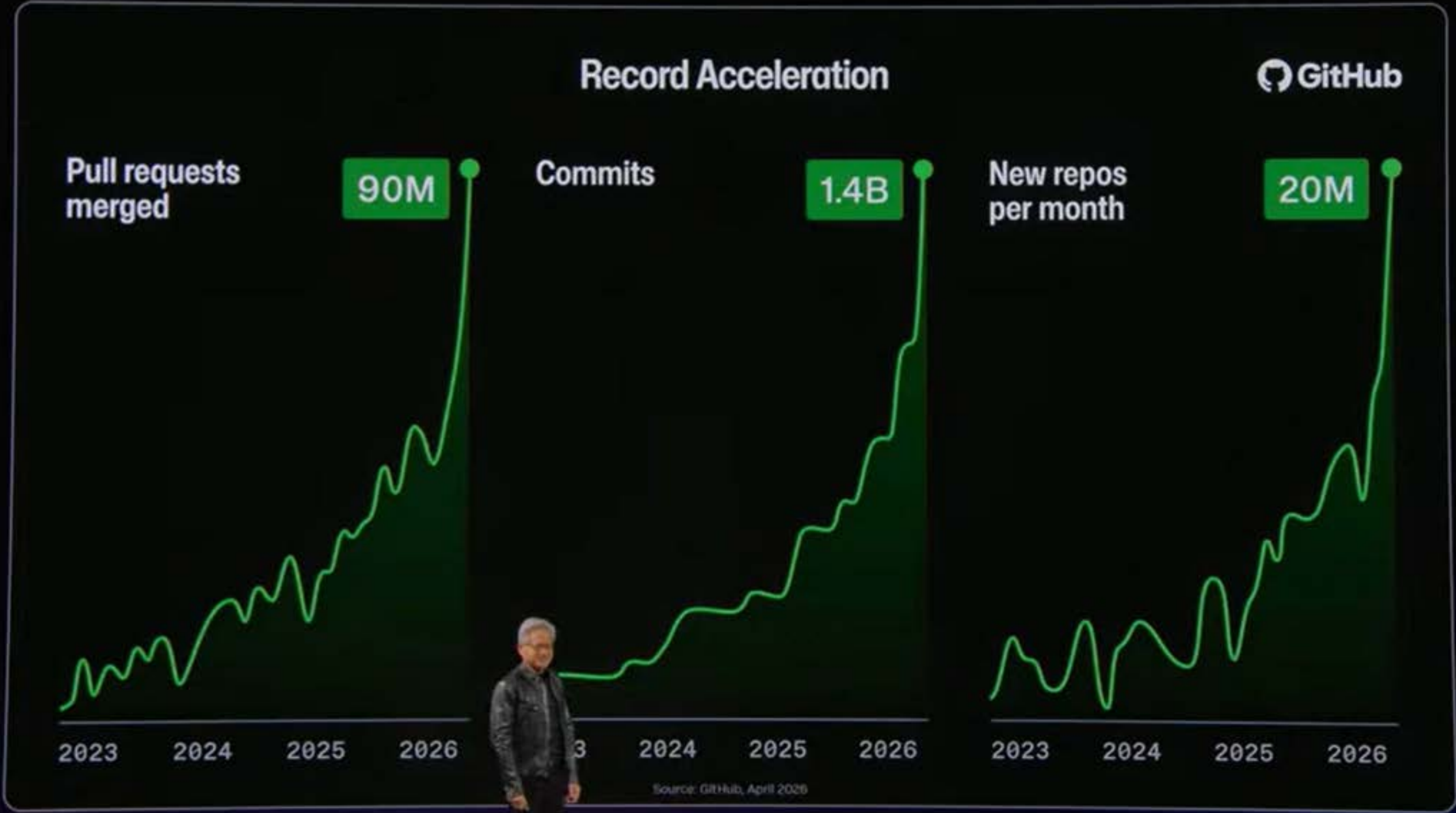


Integration



Innovation

One Alliance • One Goal



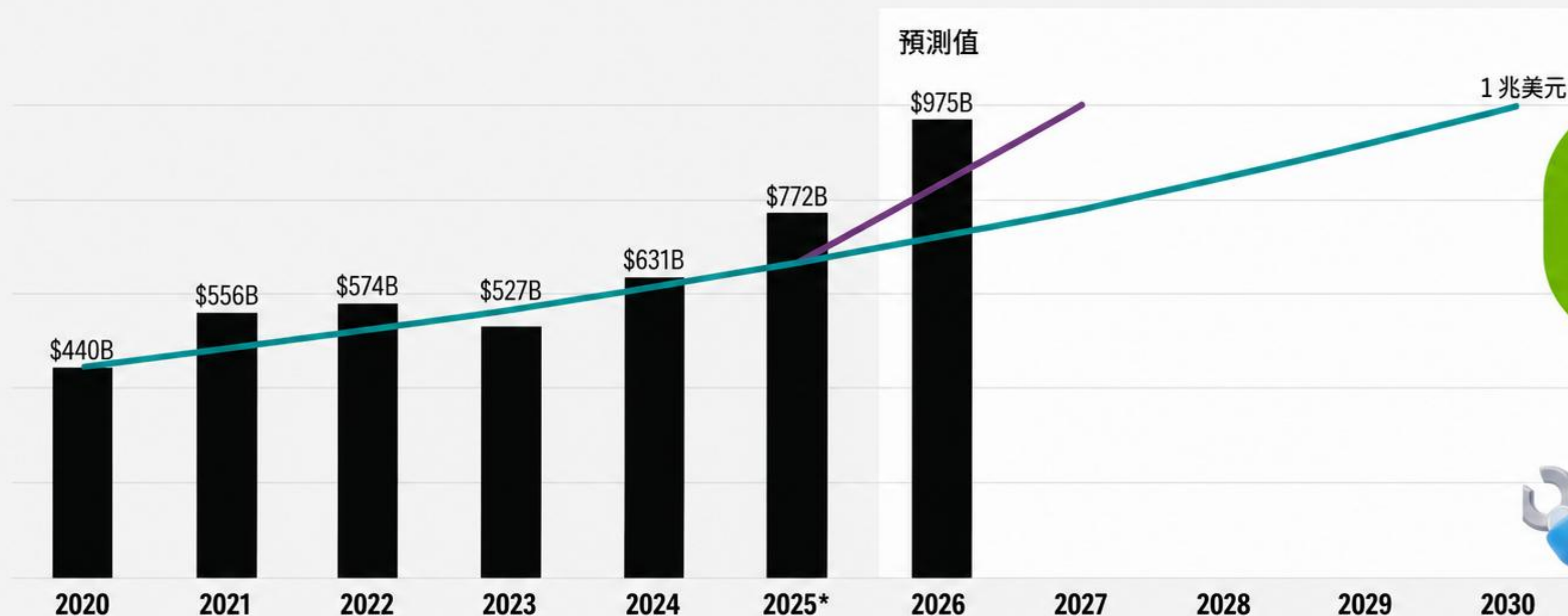
全球半導體市場預計將於 2027 年成為 1 兆美元產業

邁向 1 兆美元半導體營收之路，美元計價

● WSTS 實際值、估計值與預測值

● 產業營收趨勢（中性情境）

● 產業營收趨勢（樂觀情境）



IDC：
預估 2030 年
將達到
1.75 兆美元



註：* = 預估值

資料來源：Deloitte 分析與外推，依據世界半導體貿易統計協會（WSTS）資料。

AI 基礎建設 2.0

瓶頸轉向 物理極限



CoWoS 尺寸

3.3x → 14x+

CoWoS Size

2024

2029+



功耗演進

1400W → 6000W → 15,360W

Power Projections

2025

2029

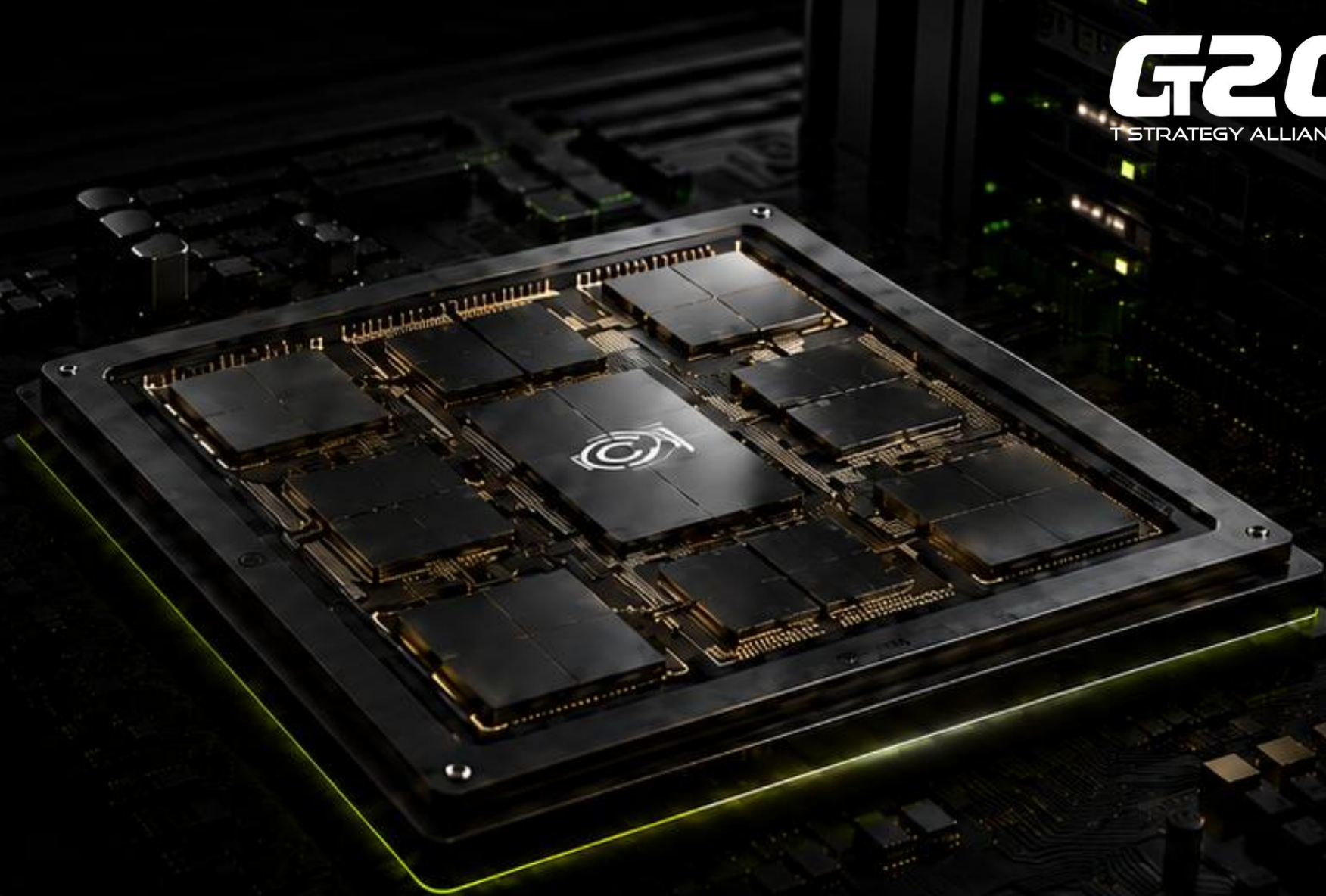
2032



算力演進

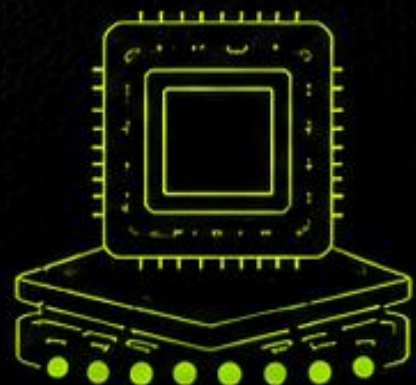
→ **物理擴張**

Compute → Physical Scaling



Foundry / OSAT 商機

先進封裝 = 第一個瓶頸

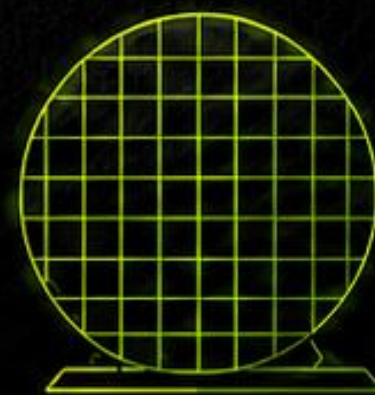


OSAT 2026

先進封裝

資本支出

(CoWoS / BSM / PLP)



Foundry 2026

先進封裝

資本支出

(CoWoS)



2024

3.3x 光罩倍數



2026

5.5x 光罩倍數



2027

9.5x 光罩倍數



Foundry: CoW / SoIC / WMCM



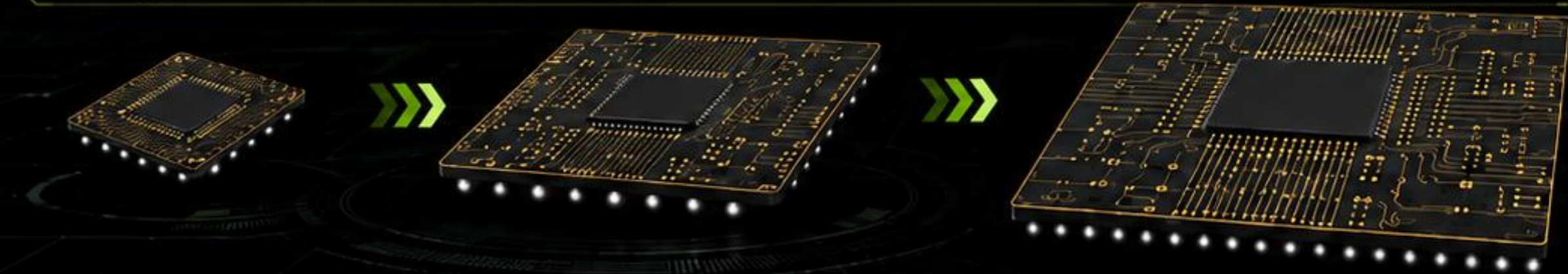
OSAT: oS / BSM / PLP

Foundry 持續擴充先進封裝；

OSAT 因應下游先進封裝需求，於 2026 年加速產能建置。

IC載板發展趨勢

更大・更厚・更密



關鍵重點



尺寸更大



層數更高



凸塊密度更高



志聖商機

- ABF壓合
- 乾膜貼附 | 線路製作
- ABF與乾膜保護膜撕除

板級製程升級

層數更多・關鍵製程控制更重要

1 2022-2024 |
16-26層 PCB



通用伺服器 / 網通 / 工業

2 2025-2026 |
iHDI / RPCB 導入



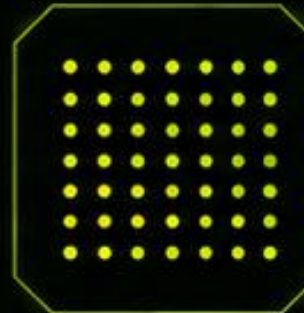
AI 伺服器 / 儲存 / 交換器

3 2026-2027 |
28-36層+ / 44層+



AI/HPC 伺服器 / mSAP / 加速器

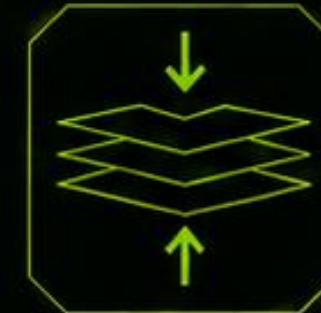
層數 ↑ → 製程複雜度 ↑
用於線路製作的乾膜貼附



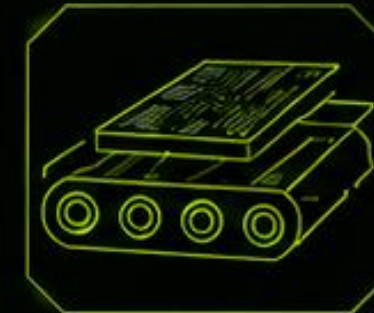
均勻性



對位



應力控制



搬送穩定性

均勻性 / 對位 / 應力控制 / 搬送穩定性

C SUN 全方位技術覆蓋

c sun志聖

晶圓代工 + 封裝測試 + 先進 PCB



晶圓代工製程

CoWoS / SoIC /
WMCM / CoPoS / COUPE



封裝測試製程

oS / BSM / CoW /
CoWoP / EMIB / PLP



先進 PCB 製程

IC 載板 / HDI /
CoWoP / EMIB



2024
3.3x 線寬世代



2028
14x 線寬世代



2029+
>14x 線寬世代



邁向更大尺寸
封裝架構

CoPoS / FoPLP
趨勢訊號

技術發展藍圖

製程全面覆蓋

未來製程需求



熱處理



壓合貼合



剝離



貼合 /
鍵合 (Bonder)



自動化

Latest Financial Performance

49.5%

Q1 毛利率 (GM%)
創歷史新高



Q1 毛利率 (GM%)
創歷史新高

+76.06%

2026 Jan~May Rev. YoY
累計營收 YoY



2026 Jan~May Rev. YoY
累計營收 YoY

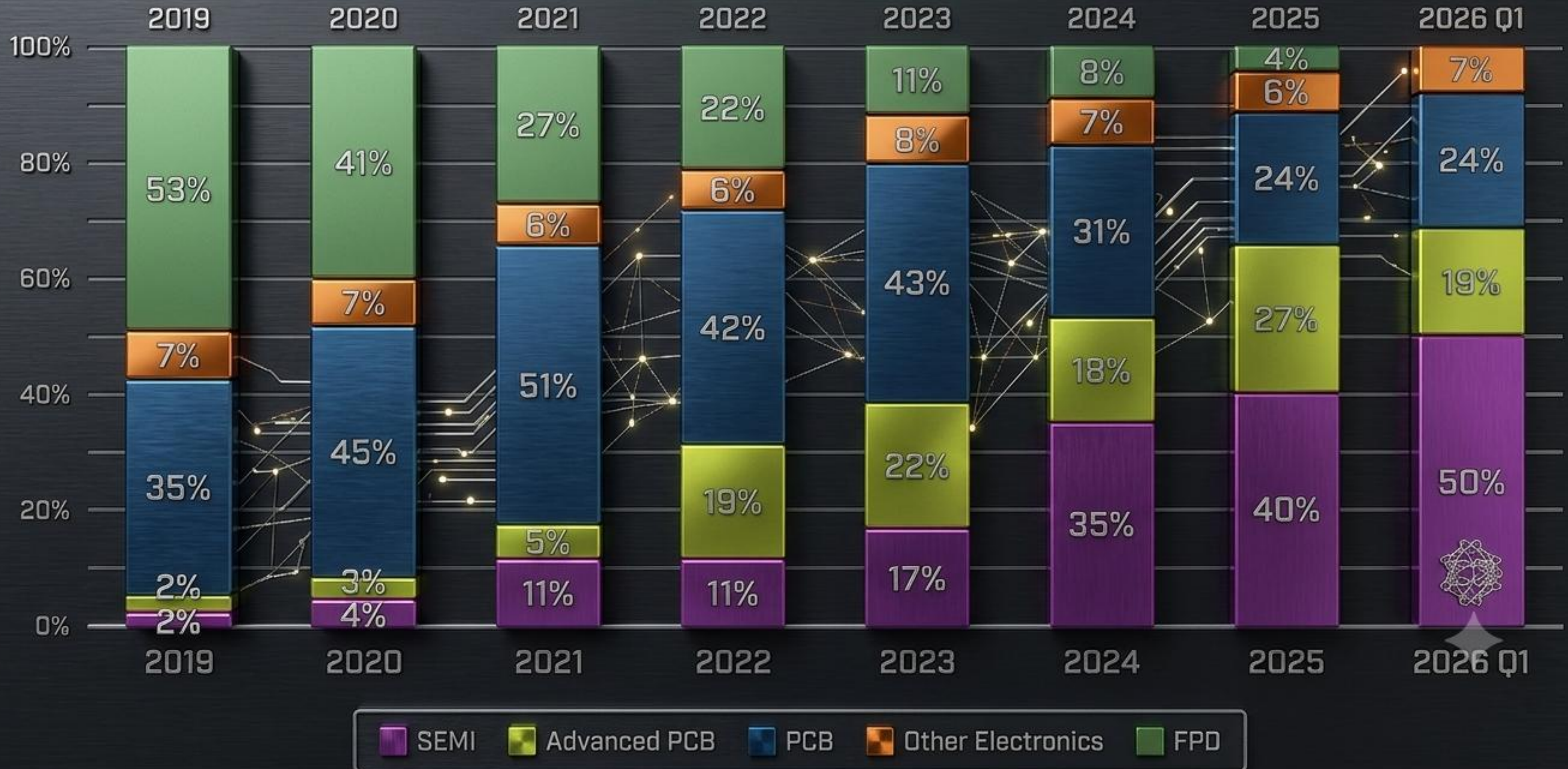
+200%

Q1 EPS YoY
Q1 EPS NT\$ 3.06



Q1 EPS YoY
Q1 EPS NT\$ 3.06

Revenue Composition



公司治理評鑑躍升

3-Year Upgrade to Top 5%

2024
80%-100%

2025
6%-20%

2026
上市公司前
5%



台灣資本市場少見的大幅改善



反映治理文化與董事會效能提升



強化資訊透明度、永續揭露與風險控管



展現快速成長下的組織升級與長期價值管理



不只受惠 AI 趨勢，更同步升級治理與資本市場溝通能力

進入國內外重要指數與 CDP 評比

—— 持續精進 ESG 實踐，提升永續競爭力 ——

成功納入以下指數



MSCI
Small Cap Indexes

MSCI Small Cap Indexes



臺灣璞玉指數

Taiwan GEM Index



臺灣中型100指數

Taiwan Mid Cap 100 Index



臺灣資訊科技指數

Taiwan Technology Index



DISCLOSURE INSIGHT ACTION

2025 年公司完成

CDP 氣候變遷問卷評比

獲得

B-

成績

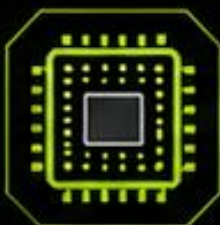


長週期成長模式

AI 基礎建設十年的 Scale Up + Scale Out

Scale Up

既有設備升級



封裝尺寸 ↑



層數增加 ↑



散熱複雜度 ↑



既有製程設備隨 AI 算力擴展持續升級演進

Scale Out

新製程擴展



共同設計



共同開發



核心技術再利用



核心技術能力延伸至下一代製程



AI 需求
創造循環



AI 複雜度
延長循環



C SUN
掌握設備升級循環

虛擬設計・實現建構

csun志聖

在虛擬中設計，在真實中實現：



製程目標



物理 + AI



虛擬設計



實體建構



一次就到位



減少迭代次數



降低風險



加速導入量產



以 Omniverse 為核心，Simulation-first，將價值前移。

***c sun*志聖**

謝謝各位 THANK YOU

攜手共創 AI 基礎建設的無限未來

BUILDING THE LIMITLESS FUTURE OF AI INFRASTRUCTURE TOGETHER

